



HT-1800



HT-1420



HT-1350

ホットプレート HTseries

予熱やリフローはんだ付け、そしてQFPやBGAの修理作業などSMT基板用に開発された、高精度で使いやすいホットプレートです。HT-1420はリワーク専用のホットプレート。HT-1350はカバー付き(HT-1350C)もあります。

仕様

機種	HT-1800	HT-1420	HT-1350
ホットプレート	100 × 100 × 15mm 2 面	3 種類 (交換して使用) 50 × 50 × 20mm 26 × 32 × 20mm 26 × 26 × 20mm	120 × 140 × 8mm
使用温度範囲	0 ~ 400℃		0 ~ 300℃
温度精度	± 1%		
センサー	熱電対 K(CA)		
温度制御	PID 制御		
ヒーター	カートリッジヒーター (300W/120V × 2 本) / 1 面	カートリッジヒーター 250W/120V × 2 本	プレートヒーター 350W
立ち上がり時間 20℃ → 200℃	8 分	1 分	7 分
適合基板サイズ	Max 100 × 100mm	Max 200 × 200mm	Max 120 × 140mm
ワークプレート	180 × 180mm	-	120 × 140mm
電源	AC100V/120V/240V		AC100/120/220/240V
	850W/100V, 1.2kW/120V	360W/100V, 510W/120V	360W
外形寸法	(W) 430 × (D) 180 × (H) 113mm	(W) 200 × (D) 220 × (H) 270mm	(W) 250 × (D) 180 × (H) 116mm
重量	5kg	2.8kg	2.5kg
特長	- 独立 2 面ホットプレート、予熱とリフローなど 2 段加熱ができます。 - 作業プレート装備。	- SMT 基板のリワーク専用ホットプレート。 - ポイントマーカ装備、大型基板でも作業が簡単。	作業プレート装備、リフローなど加熱後のワークの取扱いが安全で簡単です。
用途	- H-IC や小型 SMT 基板の予熱やリフローはんだ付け。 - 接着剤の熱硬化。 - 高精度温度テスト。	- SMT 基板のリワーク作業。 - QFP や PLCC の取り外し / 再実装。 - 基板などの局部加熱。	- H-IC や小型 SMT 基板の予熱やリフローはんだ付け。 - 接着剤の熱硬化。 - その他予熱、加熱作業。

※ 本仕様は予告なく変更することがあります。